

NEW

ETF Line-up

AI 반도체, 글로벌 MLCC & AI기판, 美 AI 에이전트
등 ETF 4종 상장

10월 2주차

키움증권 리서치센터 글로벌리서치팀
ETF Analyst 김진영 | RA 조호준



✓ New ETF 개요

상장 개요

'26.10.13(화) 국내 증시에 ETF 4종목 신규 상장 예정

*상장일(2026. 10. 13) 기준 ETF 상장종목수: 총 1,176종목

상품 요약

▲ DS AI반도체액티브 (0243M0)

- 국내 반도체 밸류체인 전반에 투자하는 액티브 ETF
- 실적이 확인되는 반도체 기업(삼성전자, SK하이닉스)을 중심으로 삼고, AI 반도체 병목 이동에 따라 AI 밸류체인과 인프라 확장되며 변동되는 수혜 산업에 액티브하게 투자

▲ ACE 29-11회사채(AA-이상)액티브 (0254W0)

- '29년 10~12월에 만기 도래하는 AA-이상 등급 특수채, 은행채, 회사채 등에 투자하는 만기매칭형(존속기한형) 액티브 ETF

▲ KIWOOM 글로벌MLCC&AI기판TOP4+ (0247S0)

- 한국, 미국, 일본 상장기업 중 MLCC 및 기판 관련 10개 기업에 투자하는 패시브 ETF
- 무라타, 삼성전기, 타이요유덴, LG이노텍 등 AI 서버의 새 병목으로 떠오른 MLCC와 AI기판 대표 기업 4개에 집중 투자

▲ KODEX 미국AI에이전트액티브 (0241D0)

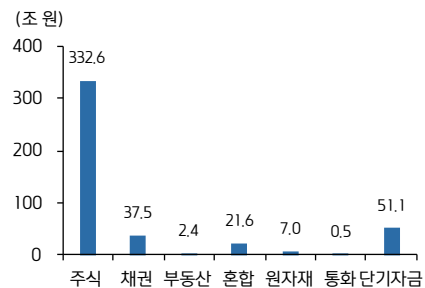
- 미국의 AI에이전트 관련 기업에 투자하는 액티브 ETF
- 스스로 계획하고 실행하는 AI 에이전트 산업의 미국 핵심기업에 투자하며, 수시로 순위가 변동하는 산업에 맞춰 종목과 비중을 조정 가능한 액티브 운용 방식 채택

ETF 시장 Snapshot

구분	'26.10.02~10.09	'26.09.25~10.02
상장 종목 수	1,172 개 (▲1 개)	1,171 개
순자산 총액	458.5 조 원 (▼7.6 조)	466.1 조 원
총 거래량	216.9 억 주 (▼103.4 억)	320.3 억 주
총 거래대금	54.2 조 원 (▼36.1 조)	90.3 조 원

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.10.09 기준

국내 ETF 유형별 순자산



자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.10.09 기준

신규 출시 ETF 개요(1)

구분	DS AI 반도체액티브	ACE 29-11회사채(AA-이상)액티브
코드	0243M0	0254W0
상품 유형	주식형	채권형
운용사	디에스자산운용	한국투자신탁운용
기초(비교) 지수	FnGuide 반도체수퍼사이클지수	KIS 크레딧 2911만기형 (AA-이상)지수(총수익지수)
복제방법	실물 (액티브)	실물 (액티브)
총보수 (운용보수)	1.00% (0.94%)	0.05% (0.035%)
연금투자 가능 여부	개인연금 100% / 퇴직연금 70%	개인연금 / 퇴직연금 100%
구성종목 수	30종목	163종목
정기 변경	3, 6, 9, 12월 선물옵션 만기일 이후 2영업일째	일별 리밸런싱

자료: KRX, 각사, 키움증권 리서치

신규 출시 ETF 개요(2)

구분	KIWOOM 글로벌 MLCC&기판 TOP4+	KODEX 미국 AI 에이전트액티브
코드	0247S0	0241D0
상품 유형	주식형	주식형
운용사	키움투자자산운용	삼성자산운용
기초(비교) 지수	iSelect 글로벌 MLCC&AI 기판 TOP4+지수	Indxx US AI Agents Index
복제방법	실물 (패시브)	실물 (액티브)
총보수 (운용보수)	0.49% (0.43%)	0.80% (0.769%)
연금투자 가능 여부	개인연금 100% / 퇴직연금 70%	개인연금 100% / 퇴직연금 70%
구성종목 수	10종목	15~17종목
정기 변경	3, 6, 9, 12월 세 번째 영업일	매월 첫번째 금요일

자료: KRX, 각사, 키움증권 리서치

| 신규 출시 ETF 한 눈에 보기

ETF 명 (코드)	DS AI반도체액티브 (0243M0)
개요	- 국내 반도체 밸류체인 전반에 투자하는 액티브 ETF
특징	- 실적이 확인되는 반도체 Top2를 중심으로 삼고, AI 반도체 병목 이동에 따른 AI 밸류체인과 인프라 확장 수혜 산업에 액티브하게 투자
비교지수	- FnGuide 반도체 수퍼사이클 지수
종목 선정 기준	▶ 유니버스: 유가증권시장 및 코스닥시장 상장 종목 - 관리종목, 투자주의환기 지정 종목, 상장폐지확정 종목, 선박투자회사, 인프라투자회사, REITs, ETF, ETN, 유동주식비율 10% 미만, 시가총액 1,000억원 미만 종목 등 제외 ▶ 선정기준: 단계에 따른 종목 선정하되 테마스코어 순위가 높은 종목 우선 선정 - 후보군 선정: 키워드*를 통한 LLM 결과 값이 0 이상인 종목 *핵심 키워드: 반도체수퍼사이클 *강화 키워드: 반도체, AI반도체, AI인프라, 반도체공급망, 반도체소부장, 반도체전공정, 반도체후공정 - 기업-테마간 유사도 스코어 x LLM 스코어 → 테마스코어 산출 - 1단계(테마 스코어 상위 50위 이내 & 유동시가총액 상위 50위 이내) → 2단계(구성종목 수가 30종목 미달 시 테마 스코어 상위 50위 이내 & 유동시가총액 상위 100위 이내 종목 추가 선정) → 3단계(구성종목 수가 30종목 미달 시 테마 스코어 상위 100위 이내 & 유동시가총액 상위 50위 이내 종목 추가 선정 → 4단계(구성종목 수가 30종목 미달 시 테마 스코어 순위 높은 종목 추가 선정) ▶ 비중결정방식: 1, 2위 (각 15%), 3~5위 (총 20% 동일배분), 6~30위(총 50% 동일배분)
출시 배경 및 투자포인트	▶ 실적으로 증명되는 삼성전자·SK하이닉스에 집중: AI 메모리 수요 확대가 실적 성장으로 이어지고 있는 국내 대표 반도체 기업을 포트폴리오의 핵심 축으로 편입, 현재 시장 컨센서스 상 삼성전자와 SK하이닉스 합산 영업이익은 2025년 91조원에서 2026년 643조원, 2027년 957조원으로 급증할 전망. AI 투자 확대와 메모리 공급 부족에 따른 이익 성장 수혜를 포트폴리오에 반영하는 전략 ▶ 칩 밖으로 확장되는 AI 병목에서 찾는 기회 요인: AI 반도체 병목은 연산(GPU)에서 HBM 같은 메모리로 확장되었고, 최근에는 첨단 패키징·후공정, 전력·냉각, 광통신, 데이터센터로 넓어지는 중. 엔비디아 Vera Rubin 역시 GPU뿐 아니라 SOCMAMM·CPU·NVLink 등 다양한 부품과 기술을 결합한 시스템으로 진화하고 있으며, 대규모 데이터센터 구축에 따른 전력·냉각·네트워크 수요도 동반 증가. AI 성장의 수혜가 소수 대표 기업에서 밸류체인 전반으로 확산되는 만큼, 기존 반도체 중심 투자에서 포착하기 어려운 새로운 성장기회에 주목 ▶ 업종 분류를 넘어 AI 매출이 생기는 곳을 찾는 액티브 운용: 투자대상을 세 유형으로 구분해 AI 산업 변화에 따른 수혜 기업을 선별. A는 본딩 장비·기판·테스트, 변압기·전력기기, 액침냉각, 광통신 등 현재의 공급 병목 구간에서 경쟁우위를 확보한 '병목 핵심기업'. B는 선박엔진→데이터센터 발전엔진, 범용 부품→AI 서버용 기판처럼 '사업이 AI로 전환되는 기업'. C는 AI 관련 매출이 본격적으로 발생하며 실적 기여도가 높아지기 시작한 '변화가 시작된 기업'. 특히 B·C 유형은 기존 반도체 업종 중심 지수에서 포착하기 어려운 투자기회로, 액티브 운용을 통해 수주·증설·실적 반영 여부를 지속 점검하고 시장 변화에 따라 편입 종목과 비중을 탄력적으로 조정
참고자료	'DS AI반도체액티브'의 2가지 축을 통한 운용 전략 DS AI반도체액티브 ETF 중심축 실적과 경쟁력이 확인된 대표 기업 기회요인 AI 인프라에서 역할이 커지는 기업 패키징·검사 전력·냉각 데이터센터 연결·광통신 중심축과 기회요인 모두 기업별 실적·경쟁력 변화에 따라 편입 여부와 비중을 조정합니다. 자료: 디에스자산운용

ETF 명 (코드)		KIWOOM 글로벌MLCC&AI기판TOP4+ (0247S0)																																																																			
개요	- 한국, 미국, 일본 상장기업 중 MLCC 및 기판 관련 10개 기업에 투자하는 패시브 ETF																																																																				
특징	- AI 서버의 새 병목으로 떠오른 MLCC와 AI기판에 집중하여 한국과 일본 상위 4개 종목에 집중 투자																																																																				
기초지수	- iSelect 글로벌MLCC&AI기판TOP4+ 지수																																																																				
종목 선정 기준	▶ 유니버스: 한국, 미국, 일본거래소에 상장된 보통주 中 - 우선주, OTC, 선박투자회사, ETF-ETN, SPAC 등 제외 ▶ 선정기준: MLCC & AI 기판 산업 관련 키워드 바탕 스코어 상위 순으로 최대 10종목 선정 - 키워드: MLCC, ABF Substrate, Advanced Packaging, AI Server, CoWoS, FC-BGA, AI 반도체 기판, 패키지기판, 반도체 패키지, 유리기판 등 - 글로벌 뉴스 기사 기초데이터로 키워드 스코어 산출해 상위 20개 종목 기초 유니버스 선정 -> 기초 유니버스 내 정량 조건* 충족 종목을 스코어 상위 순으로 최대 10종목 선정(10종목 미달 시 완화된 정량 조건 사용) *정량 조건: 심사일(정기변경일 직전 달 마지막 영업일) 기준 20영업일 평균 시가총액 20억 달러 이상 및 20영업일 평균 거래대금 5,000만 달러 이상. 완화 조건은 평균 시가총액 10억 달러 이상 및 평균 거래대금 2,000만 달러 이상으로 완화 ▶ 비중결정방식: 1~2위(각 25%), 3~4위(각 15%), 5~10위(시가총액 가중방식)																																																																				
출시 배경 및 투자포인트	▶ AI 서버의 병목, 칩에서 부품으로 이동: 빅테크 4개사 설비투자가 2025년 3,747억 달러에서 2027년 1조 달러로 확대될 전망이다. AI 서버의 공급 병목도 칩에서, 칩에 전기와 신호를 대는 부품으로 확산되어 가는 중. 해외에서는 8월 중순 이후 한 달 사이 미국에서만 MLCC를 담은 ETF 4종이 새로 상장할 만큼 시장이 먼저 반응 ▶ MLCC는 칩 옆의 댐, AI기판은 데이터 고속도로: MLCC는 AI 칩의 순간적인 전력 수요에 대응해 전압을 안정적으로 유지하는 부품으로, GPU당 탑재량이 H100 약 200개에서 루빈 약 5,000개로 25배 증가할 전망. 고사양 MLCC는 범용 제품 대비 생산능력을 4~7배 더 소모하고 핵심 장비 납기도 2~3년에 달해, 연 10~15% 수준의 공급능력 확대가 AI용 수요 증가율(연 80% 이상)을 따라가기 어려운 구조. 한편 FC-BGA는 GPU와 메인보드를 연결하는 핵심 패키지기판으로, 엔비디아의 차세대 베라 루빈용 기판 면적은 GB200 대비 약 1.5배 확대. 반도체 미세공정의 한계와 패키징 중요성 확대로 고성능 MLCC와 AI기판의 기술 진입장벽 및 공급업체의 가격 협상력이 높아지는 국면 ▶ MLCC-AI기판 핵심 TOP4에 80% 집중: 기초지수 iSelect 글로벌MLCC&AI기판TOP4+ 지수를 따라 산업 관련성이 높은 10개 종목에 투자하며, 키워드 스코어 1~2위에 각 25%, 3~4위에 각 15%를 배분하고 나머지 6종목은 유동시가총액에 따라 종목당 최대 5%까지 담는 구조. 글로벌 MLCC 1위 무라타(25%), MLCC와 패키지기판을 함께 만드는 기업인 삼성전기(25%), 대용량 MLCC 세계 3위 타이오유덴(15%), AI 반도체용 FC-BGA 사업을 키우고 있는 LG이노텍(15%)이 TOP4이며, 한국과 일본 비중 50%씩 투자																																																																				
참고자료	'KIWOOM 글로벌MLCC&AI기판TOP4+' 구성종목 예시 <table><tr><th></th><th>종목</th><th>국적</th><th>비중</th><th>제품 분류</th><th>특징</th></tr><tr><td>1</td><td>무라타 제작소</td><td></td><td>25.0%</td><td>MLCC</td><td>AI 서버 전장용 고부가 MLCC를 생산하는 종합 전자부품 기업. 소형·고용량·적층 세라믹 부품이 주력</td></tr><tr><td>2</td><td>삼성전기</td><td></td><td>25.0%</td><td>MLCC, AI기판</td><td>AI 서버 전장용 MLCC와 FC-BGA 패키지기판을 함께 생산. 국내에서 FC-BGA를 대량 양산하여 두 축을 모두 보유</td></tr><tr><td>3</td><td>타이오 유덴</td><td></td><td>15.0%</td><td>MLCC</td><td>모바일·전장 산업용 MLCC가 주력인 적층 세라믹 부품 기업. 소형·고용량 제품에 강점</td></tr><tr><td>4</td><td>LG이노텍</td><td></td><td>15.0%</td><td>AI기판</td><td>FC-BGA 사업에 신규 진출해 AI기판 축을 확대 중. 코어리스 기술을 차세대 FC-BGA에 응용</td></tr><tr><td>5</td><td>두산</td><td></td><td>5.0%</td><td>AI기판(소재)</td><td>FC-BGA-PCB의 핵심 소재인 CCL(동박적층판)을 생산. AI 가속기용 저손실 CCL을 공급</td></tr><tr><td>6</td><td>아버덴</td><td></td><td>5.0%</td><td>AI기판</td><td>AI 서버용 FC-BGA(ABF 기판)를 생산. 엔비디아용 AI 기판 생산능력을 대규모로 확대 중</td></tr><tr><td>7</td><td>TDK</td><td></td><td>5.0%</td><td>MLCC</td><td>MLCC·인덕터 등 수동부품과 배터리를 생산하는 종합 전자부품 기업. 적층 세라믹 부품이 주요 품목</td></tr><tr><td>8</td><td>아수페티시스</td><td></td><td>2.2%</td><td>AI기판</td><td>AI 서버 데이터센터용 고다층 PCB(MLB)를 생산하는 전문 PCB 기업. 고속·고용량 데이터 처리를 위한 네트워크 서버용 기판에 강점</td></tr><tr><td>9</td><td>대덕전자</td><td></td><td>1.5%</td><td>AI기판</td><td>메모리 패키지기판 FC-BGA를 생산하는 PCB 기업. 서버·자율주행용 FC-BGA 사업을 확대 중</td></tr><tr><td>10</td><td>삼척</td><td></td><td>1.3%</td><td>AI기판</td><td>메모리 모듈 패키지기판 전문 PCB 기업. AI 서버용 차세대 메모리 모듈(SoCMM) 패키지기판에 강점</td></tr></table> 자료: iSelect, 키움투자자산운용 주) 2026.09.03 기준. 구성종목 및 비중은 향후 시장상황 및 기초지수 리밸런싱 등에 따라 달라질 수 있음				종목	국적	비중	제품 분류	특징	1	무라타 제작소		25.0%	MLCC	AI 서버 전장용 고부가 MLCC를 생산하는 종합 전자부품 기업. 소형·고용량·적층 세라믹 부품이 주력	2	삼성전기		25.0%	MLCC, AI기판	AI 서버 전장용 MLCC와 FC-BGA 패키지기판을 함께 생산. 국내에서 FC-BGA를 대량 양산하여 두 축을 모두 보유	3	타이오 유덴		15.0%	MLCC	모바일·전장 산업용 MLCC가 주력인 적층 세라믹 부품 기업. 소형·고용량 제품에 강점	4	LG이노텍		15.0%	AI기판	FC-BGA 사업에 신규 진출해 AI기판 축을 확대 중. 코어리스 기술을 차세대 FC-BGA에 응용	5	두산		5.0%	AI기판(소재)	FC-BGA-PCB의 핵심 소재인 CCL(동박적층판)을 생산. AI 가속기용 저손실 CCL을 공급	6	아버덴		5.0%	AI기판	AI 서버용 FC-BGA(ABF 기판)를 생산. 엔비디아용 AI 기판 생산능력을 대규모로 확대 중	7	TDK		5.0%	MLCC	MLCC·인덕터 등 수동부품과 배터리를 생산하는 종합 전자부품 기업. 적층 세라믹 부품이 주요 품목	8	아수페티시스		2.2%	AI기판	AI 서버 데이터센터용 고다층 PCB(MLB)를 생산하는 전문 PCB 기업. 고속·고용량 데이터 처리를 위한 네트워크 서버용 기판에 강점	9	대덕전자		1.5%	AI기판	메모리 패키지기판 FC-BGA를 생산하는 PCB 기업. 서버·자율주행용 FC-BGA 사업을 확대 중	10	삼척		1.3%	AI기판	메모리 모듈 패키지기판 전문 PCB 기업. AI 서버용 차세대 메모리 모듈(SoCMM) 패키지기판에 강점
	종목	국적	비중	제품 분류	특징																																																																
1	무라타 제작소		25.0%	MLCC	AI 서버 전장용 고부가 MLCC를 생산하는 종합 전자부품 기업. 소형·고용량·적층 세라믹 부품이 주력																																																																
2	삼성전기		25.0%	MLCC, AI기판	AI 서버 전장용 MLCC와 FC-BGA 패키지기판을 함께 생산. 국내에서 FC-BGA를 대량 양산하여 두 축을 모두 보유																																																																
3	타이오 유덴		15.0%	MLCC	모바일·전장 산업용 MLCC가 주력인 적층 세라믹 부품 기업. 소형·고용량 제품에 강점																																																																
4	LG이노텍		15.0%	AI기판	FC-BGA 사업에 신규 진출해 AI기판 축을 확대 중. 코어리스 기술을 차세대 FC-BGA에 응용																																																																
5	두산		5.0%	AI기판(소재)	FC-BGA-PCB의 핵심 소재인 CCL(동박적층판)을 생산. AI 가속기용 저손실 CCL을 공급																																																																
6	아버덴		5.0%	AI기판	AI 서버용 FC-BGA(ABF 기판)를 생산. 엔비디아용 AI 기판 생산능력을 대규모로 확대 중																																																																
7	TDK		5.0%	MLCC	MLCC·인덕터 등 수동부품과 배터리를 생산하는 종합 전자부품 기업. 적층 세라믹 부품이 주요 품목																																																																
8	아수페티시스		2.2%	AI기판	AI 서버 데이터센터용 고다층 PCB(MLB)를 생산하는 전문 PCB 기업. 고속·고용량 데이터 처리를 위한 네트워크 서버용 기판에 강점																																																																
9	대덕전자		1.5%	AI기판	메모리 패키지기판 FC-BGA를 생산하는 PCB 기업. 서버·자율주행용 FC-BGA 사업을 확대 중																																																																
10	삼척		1.3%	AI기판	메모리 모듈 패키지기판 전문 PCB 기업. AI 서버용 차세대 메모리 모듈(SoCMM) 패키지기판에 강점																																																																

ETF 명 (코드)	KODEX 미국AI에이전트액티브 (0241D0)
개요	- 미국의 AI에이전트 관련 기업에 투자하는 액티브 ETF
특징	- 스스로 계획하고 실행하는 AI 에이전트 산업의 미국 핵심기업에 투자하며, 수시로 순위가 변동하는 산업에 맞춰 종목과 비중을 조정 가능한 액티브 운용 방식 채택
비교지수	- Indxx US AI Agents Index
종목 선정 기준	▶ 유니버스: 미국 상장 보통주 및 ADR 中 - 시가총액 10억달러 이상, 6개월 평균 거래대금 1,000만 달러 이상. 단, 주가 1만달러 이상 종목은 제외 - 최근 6개월 거래일 중 90% 이상 거래, 유동주식비율 10% 이상 ▶ 선정기준: AI에이전트 테마로부터 50% 이상 수익 창출 종목 내 LLM 점수 50점 이상인 종목 15~17개 선정 - AI에이전트 키워드: Photonics & Networking, Servers & Infra, AI Silicon & Accelerator Systems, Enterprise AI Software, Data & Security, Semiconductor Equipment & Materials, Power & Energy, Data Persistence - 회사 연례 보고서·공시 등을 바탕으로 LLM 점수 산출 후 50점 이상인 종목 선정(17개 이상인 경우 LLM 스코어 순으로 상위 17개 선정, 15개 미만인 경우 LLM 스코어 차상위 기업 편입하여 15개 기업 선정) ▶ 비중결정방식: 종목 수에 따라 비중 달리 산정 - 최종 구성종목 17종목인 경우에는 2위와 3위 LLM 스코어 차이가 5점을 초과하는 경우 Case 3-1, 5점 이하인 경우 Case 3-2 - Case1: 1~2위 24%, 3~15위 4% / Case2: 1~3위 16%, 4~16위 4% / Case3: 1~2위 20%, 3~17위 4% / Case4: 1~3위 10%, 4~17위 5%
출시 배경 및 투자포인트	▶ 스스로 일하는 AI 에이전트 시대의 개막: 질문에 답하는 기존 챗봇과 달리, AI 에이전트는 목표만 주면 스스로 계획을 세우고 검색·분석·검증을 거쳐 결과물까지 완성. 이 과정을 반복하면서 일반 챗봇보다 약 10~100배 많은 토큰을 사용하며, 에이전트 활용이 늘어날수록 반도체·데이터센터·네트워크 수요도 함께 확대되는 구조. Meta의 개인형 AI 에이전트 '메타 뮤즈'가 출시 열흘 만에 미국 앱스토어 무료 앱 1위에 오르는 등 일부 얼리어답터의 도구에서 대중적인 서비스로 확산 중 ▶ 미국이 주도하는 AI 에이전트의 본격 성장 계도: 글로벌 AI 에이전트 시장은 2025년 약 83억 달러에서 2030년 약 532억 달러로 연평균 약 44.9% 성장할 전망. 그 중 북미가 2025년 기준 글로벌 시장의 약 41%를 차지하며 성장을 주도하고 있으며, 글로벌 빅테크의 2026년 AI 인프라 투자도 전년대비 약 79% 증가할 전망. 현재 AI 에이전트 도입을 완료한 미국 주요 기업은 약 15%에 불과하지만, 약 65%가 향후 1~2년 내 도입을 계획하고 있어 기업용 AI 에이전트 수요가 본격 확대되는 국면 ▶ 1등이 수시로 바뀌는 산업, 액티브로 기만하게: 최근 약 2년간 프론티어 AI 모델의 상위 5위권 순위가 138차례 변동하는 등 OpenAI·Anthropic·Google·Meta·xAI·DeepSeek 간 기술 경쟁 심화. AI 에이전트 생태계는 반도체·전력 인프라부터 네트워크, AI 모델, 에이전트 서비스, 보안까지 밸류체인 전반에 걸쳐 있어 다음 성장 기회가 어느 영역에서 나타날지 예측하기 어려운 구조. 따라서 정해진 규칙에 따라 투자하는 패시브 방식보다 기술 발전과 산업 주도권 변화에 맞춰 투자 종목과 비중을 유연하게 조정하는 액티브 운용 전략 활용
참고자료	여러 계층에서 기회가 예상되는 AI 에이전트 생태계 전반에 투자하는 'KODEX 미국AI에이전트액티브'  자료: 삼성자산운용

국내 신규출시 ETF 리스트 (최근 1개월)

상장일	티커	ETF 명	AuM (억원)	개요
09/15	0227L0	HANARO 미국에이전틱 AI TOP2+	107	미국 에이전틱 AI* 모델 개발 및 관련 서비스 기업 10 종목에 투자하는 패시브 ETF *에이전틱 AI: 목표달성을 위해 '인자-계획 수립-실행'을 스스로 수행하는 AI
09/15	0238F0	KODEX 미국 AI 메모리 TOP2 플러스	728	미국 메모리 및 스토리지 관련 기업 10 종목에 투자하는 패시브 ETF
09/15	0239Z0	PLUS AI 반도체소부장액티브	405	국내 AI 반도체 산업 성장에 따라 수혜가 기대되는 소재·부품·장비 기업에 투자하는 액티브 ETF
09/15	0239Y0	PLUS 코리아 HBM 반도체	162	국내 메모리반도체 제조사 및 장비·기판·소재기업 10 종목에 투자하는 패시브 ETF
09/22	0238C0	IBK 한미대표기업 TOP2+채권혼합 50 액티브	228	한국·미국의 시가총액 1 위 기업과 통안채를 5:5 비중으로 투자하되 일부 종목을 추가 편입하여 초과수익을 추구하는 액티브 ETF
09/22	0240J0	RISE 삼성 SK 그룹	708	삼성·SK 그룹의 상장회사를 유니버스로 하여 유동시가총액 상위 10 종목에 투자하는 패시브 ETF
09/22	0241R0	TIGER 현대차 LG 전자고정퍼지컬 AI 밸류체인	191	현대차, LG 전자 (각 25%) 및 국내외 퍼지컬 AI 관련 기업에 투자하는 패시브 ETF
09/22	0242S0	파워 SK 그룹	149	SK 그룹의 상장회사에 투자하는 패시브 ETF
10/07	0246X0	SOL 글로벌 DRAM 반도체플러스	968	한국, 미국, 일본 거래소에 상장된 메모리 반도체 관련 기업에 집중 투자하는 패시브 ETF

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.10.09 기준

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제 3 자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.